

定制聚四氟乙烯晶圆承载清洗篮 耐腐蚀无析出 高分子实验支架

货号: PL-CP264



简介

专为半导体和高分子研究设计的高性能定制聚四氟乙烯晶圆承载器与清洗篮，具备出色的耐腐蚀性与零析出特性，可为严苛化学环境中的加工提供无污染保障，适用于当今高精度实验室与工业应用场景。

了解更多

应用场景	说明	核心优势
半导体湿法刻蚀	在酸性刻蚀工艺中固定硅晶圆，用于去除氧化层或定义图形。	化学惰性避免溶液污染。
痕量金属分析	在高纯酸浴中清洗实验器皿和样品，用于环境或地质研究。	零金属析出保证分析准确性。
高分子合成	在高温溶剂反应中支撑催化剂载体或基片。	高热阻与不沾表面。
太阳能电池制造	承载大尺寸硅基片完成多阶段清洗与结构化处理。	结构坚固，满足大产能处理需求。
制药清洗	在强去污溶液中对精密玻璃或金属部件进行灭菌清洗。	符合高纯度与无污染标准。
电化学沉积	在腐蚀性电解质溶液的金属电镀或沉积过程中固定基片。	电绝缘性与化学稳定性。
光电子加工	在LED和激光二极管生产中清洗和处理玻璃或蓝宝石基片。	无划痕承载，无残留漂洗。
高温干燥	将晶圆从湿浴直接转移至加热干燥腔或烘箱。	最高260°C仍保持结构完整。

特性	规格详情 (PL-CP264系列)
产品标识	PL-CP264 定制晶圆承载器
主体材料	高纯全新料聚四氟乙烯 (可选可溶性聚四氟乙烯PFA)
定制属性	100% 量身定制/按订单生产
温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
化学兼容性	通用兼容 (所有酸、碱、溶剂，熔融碱金属除外)
卡槽配置	可定制 (宽度、间距、角度与深度)
晶圆兼容性	支持1英寸、2英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸或非标准形状定制尺寸
加工方式	高精度CNC加工
表面处理	光滑、低摩擦、无孔隙
手柄选项	集成式、可拆卸式或机械接口
批次容量	按用户要求设计 (单晶圆或多晶圆)